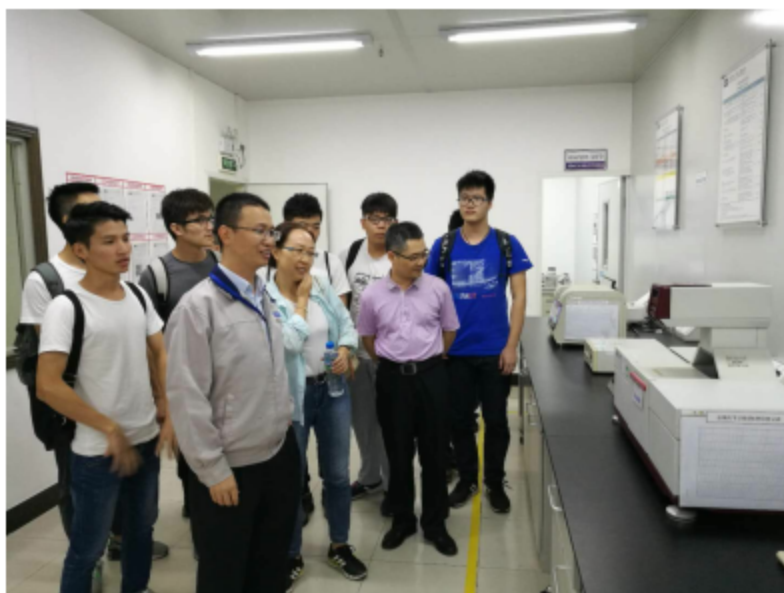


2017 届 PCB 创新班赴广合科技有限公司参观实习

经 GPCA 陈世荣副秘书长引荐以及广合科技公司的大力支持,2017 年 10 月 28 日(周六)下午 2 点,广东工业大学 PCB 创新学院郝志峰副院长、胡光辉副院长携 2017 届 PCB 创新班到广合科技(广州)有限公司进行参观学习,广合科技总经办黎钦源总监、人力资源部王启典经理、研发部彭镜辉经理等进行了热烈接待。



首先,黎总监向同学们介绍了广合科技有限公司的基本情况、发展历程,让大家对广合科技的产能、发展目标有了大体的了解。接着,黎总监对线路板的生产流程进行了讲解,并展示了大量的相关仪器设备,让同学们感受到了印制线路板生产工序的复杂、精密和高科技含量。之后,为了让同学们切身体会生产过程,分成不同小组,每组安排一位工程人员现场讲解。看到干净整洁的实验室和生产车间,同学们一扫先入为主的观念,改变了工厂企业很脏的印象。在走生产流程的过程中,部分同学初次进工厂,既新奇又兴奋,一路咨询了许多好奇的问题,此次现场参观过程大家普遍反映收获良多。



最后，百忙之中的曾红总经理也抽出时间来和大家见面，她非常欢迎广东工业大学的PCB创新班来学习参观，鼓励大学生走进公司的实验室，并期望他们将来能够加入广合科技有限公司。



非常感谢广合科技有限公司全体成员的热情接待和对参观实习的大力支持，祝福他们早日实现生产目标，也祝愿广工与广合的合作走上新台阶！